DS90UB971-Q1 具有 CSI-2 接口且适用于 8MP+ 摄像头、雷达和其他传感器的 FPD-Link IV 7.55Gbps 串行器

1 特性

- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准：
  - 器件温度：指定了 -40°C 至 115°C 的环境工作温度范围以提高电气性能
- 7.55Gbps （6Gbps 视频有效载荷）支持高速传感器（包括 8MP+ 成像仪）
- 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
- 具有 4 个通道的单个 MIPI D-PHY 端口
  - 符合 MIPI D-PHY v2.1 标准
  - 1 个时钟通道和 1、2 或 4 个可配置数据通道
  - 每个通道不超过 1.5Gbps，每个端口不超过 6Gbps
  - 支持极性引脚反转 (p/n)
  - 16 个虚拟通道
- 单端口 MIPI CSI-2 接收器
  - 符合 MIPI CSI-2 v2.1 标准
  - 支持多种数据类型和多次曝光
- 高级数据保护与诊断（包括：CRC 数据保护、传感器数据完整性检查、I2C 写保护、电压与温度测量、可编程警报以及线路故障检测）
- 灵活的可编程输出时钟发生器
- 支持单端同轴或屏蔽双绞线（STP）电缆
- 超低延迟双向 I2C 与 GPIO 控制通道，支持通过 ECU 进行 ISP 控制
- 单个 1.8 V 电源
- 兼容 DS90UB9702-Q1、DS90UB954-Q1、DS90UB936-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB962-Q1 解串器
- 与 DS90UB953-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB951-Q1 串行器引脚相兼容
- 小型 5mm × 5mm VQFN 封装与解决方案尺寸，适合紧凑型传感器模块设计
- 功能安全合规型
  - 专为功能安全应用开发
  - 可提供辅助达到 ASIL B 级别的 ISO 26262 系统设计的文档

2 应用

- 汽车驾驶员辅助系统 (ADAS)
  - 环视系统 (SVS)
  - 摄像头监控系统 (CMS)
  - 前视摄像头 (FC)
  - 驾驶员监控系统 (DMS)
  - 后视摄像头 (RVC)
  - 汽车卫星雷达与激光雷达模块
  - 飞行时间 (ToF) 传感器
- 安防与监控摄像头
- 工业与医疗成像

3 说明

DS90UB971-Q1 串行器是第一代 FPD-Link IV 串行器，旨在支持包括 8MP+ 成像仪、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器在内的超高速原始数据传感器。该芯片能够提供 7.55Gbps 正向通道与超低延迟 47.1875Mbps 双向控制通道，并且支持通过单根同轴（PoC）或 STP 电缆供电。DS90UB971-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能，可支持 ADAS 和汽车功能安全。DS90UB971-Q1 与配套的解串器一起提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。

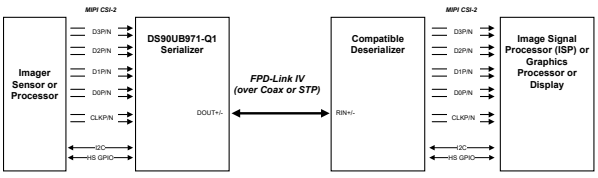
DS90UB971-Q1 完全符合 AEC-Q100 标准，以及 -40°C 至 115°C。该串行器采用 5mm × 5mm 小型 VQFN 封装，适用于空间受限型传感器应用。

器件信息

器件型号	封装 (1)	本体尺寸（标称值）(2)
DS90UB971-Q1	VQFN (32)	5.00mm × 5.00mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

(2) 封装尺寸（长 × 宽）为标称值，并包括引脚（如适用）。



典型应用

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见，TI 提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性，请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本（控制文档）。

4 器件和文档支持

4.1 相关文档

如需获取安全文档，请联系 TI。

请参阅以下相关文档：

- *通过支持双向控制通道的 FPD-Link III 进行 I2C 通信*
- *I2C 总线上拉电阻器计算*

4.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击*通知* 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

4.3 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的使用条款。

4.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
所有商标均为其各自所有者的财产。

4.5 静电放电警告

静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

4.6 术语表

TI 术语表　　本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

5 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (December 2023) to Revision A (January 2025)	Page
• 新增了“安全相关认证”要点	1

6 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
DS90UB971RHBRQ1	Active	Production	VQFN (RHB) | 32	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 115	UB971Q
DS90UB971RHBRQ1.A	Active	Production	VQFN (RHB) | 32	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 115	UB971Q
DS90UB971RHBTQ1	Active	Production	VQFN (RHB) | 32	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 115	UB971Q
DS90UB971RHBTQ1.A	Active	Production	VQFN (RHB) | 32	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 115	UB971Q

(1) **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

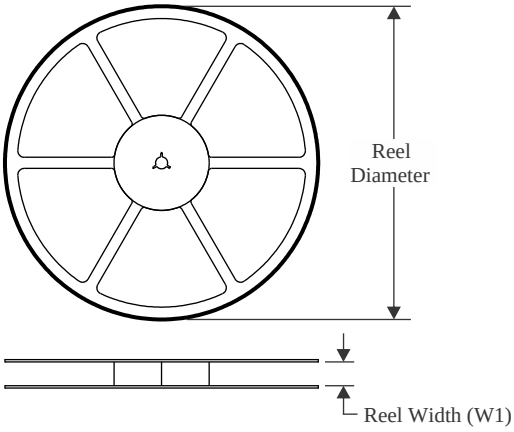
Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

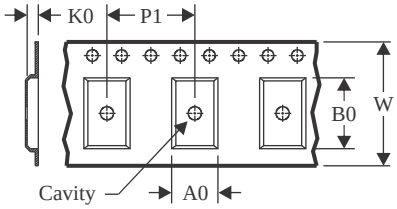
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION

REEL DIMENSIONS

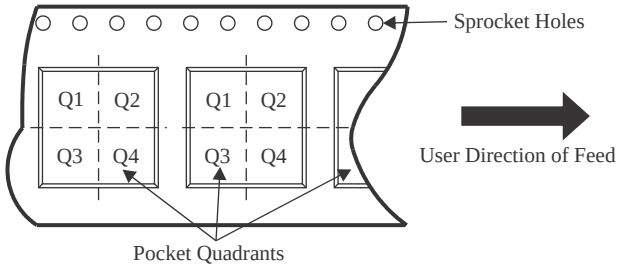


TAPE DIMENSIONS



A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

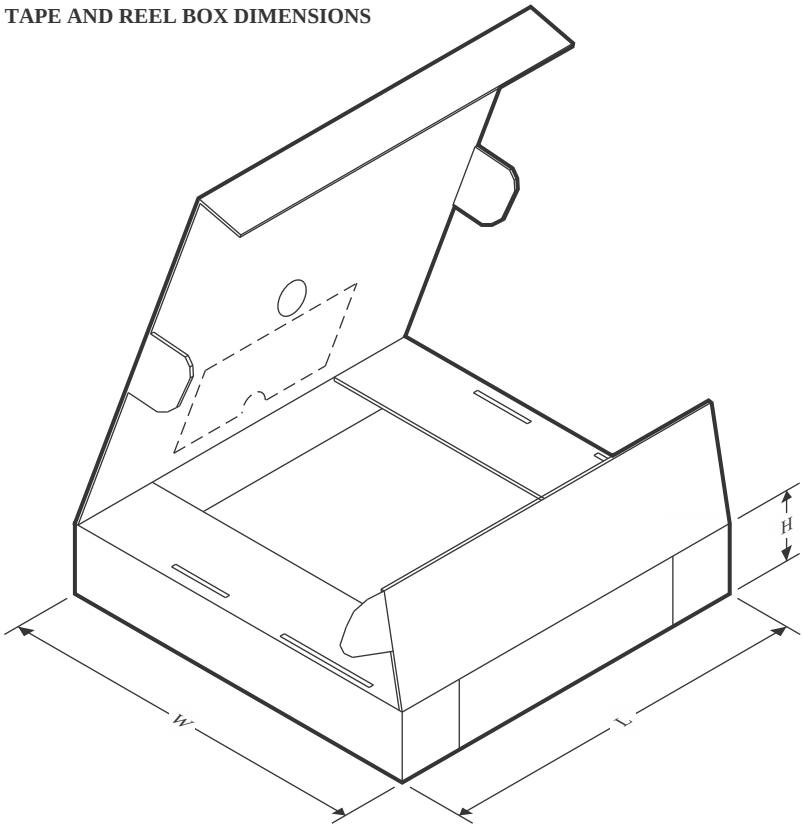
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
DS90UB971RHBRQ1	VQFN	RHB	32	3000	330.0	12.4	5.3	5.3	1.1	8.0	12.0	Q2
DS90UB971RHBRQ1	VQFN	RHB	32	3000	330.0	12.4	5.3	5.3	1.1	8.0	12.0	Q2
DS90UB971RHBTQ1	VQFN	RHB	32	250	180.0	12.4	5.3	5.3	1.1	8.0	12.0	Q2
DS90UB971RHBTQ1	VQFN	RHB	32	250	180.0	12.4	5.3	5.3	1.1	8.0	12.0	Q2

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
DS90UB971RHBRQ1	VQFN	RHB	32	3000	346.0	346.0	33.0
DS90UB971RHBRQ1	VQFN	RHB	32	3000	367.0	367.0	35.0
DS90UB971RHBTQ1	VQFN	RHB	32	250	210.0	185.0	35.0
DS90UB971RHBTQ1	VQFN	RHB	32	250	210.0	185.0	35.0

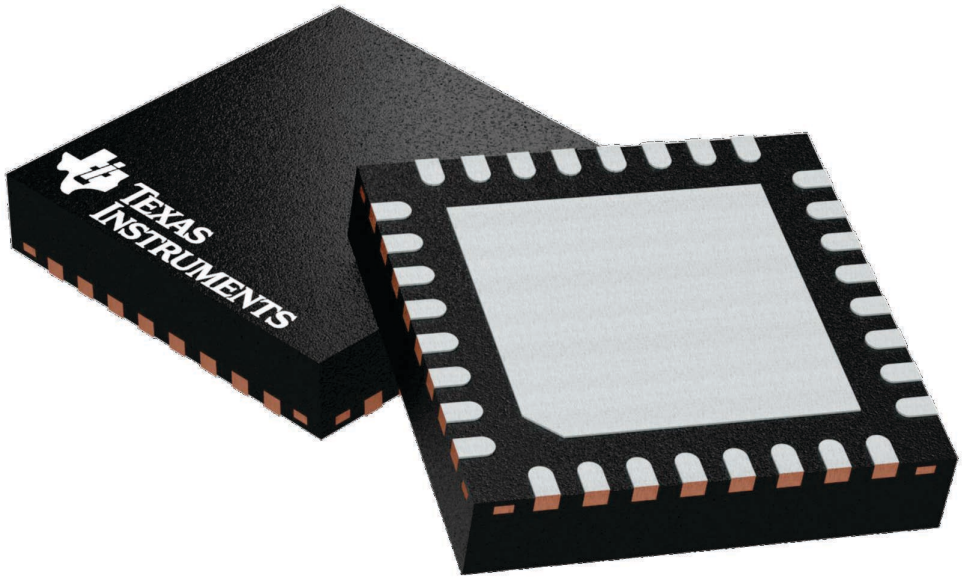
GENERIC PACKAGE VIEW

RHB 32

VQFN - 1 mm max height

5 x 5, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

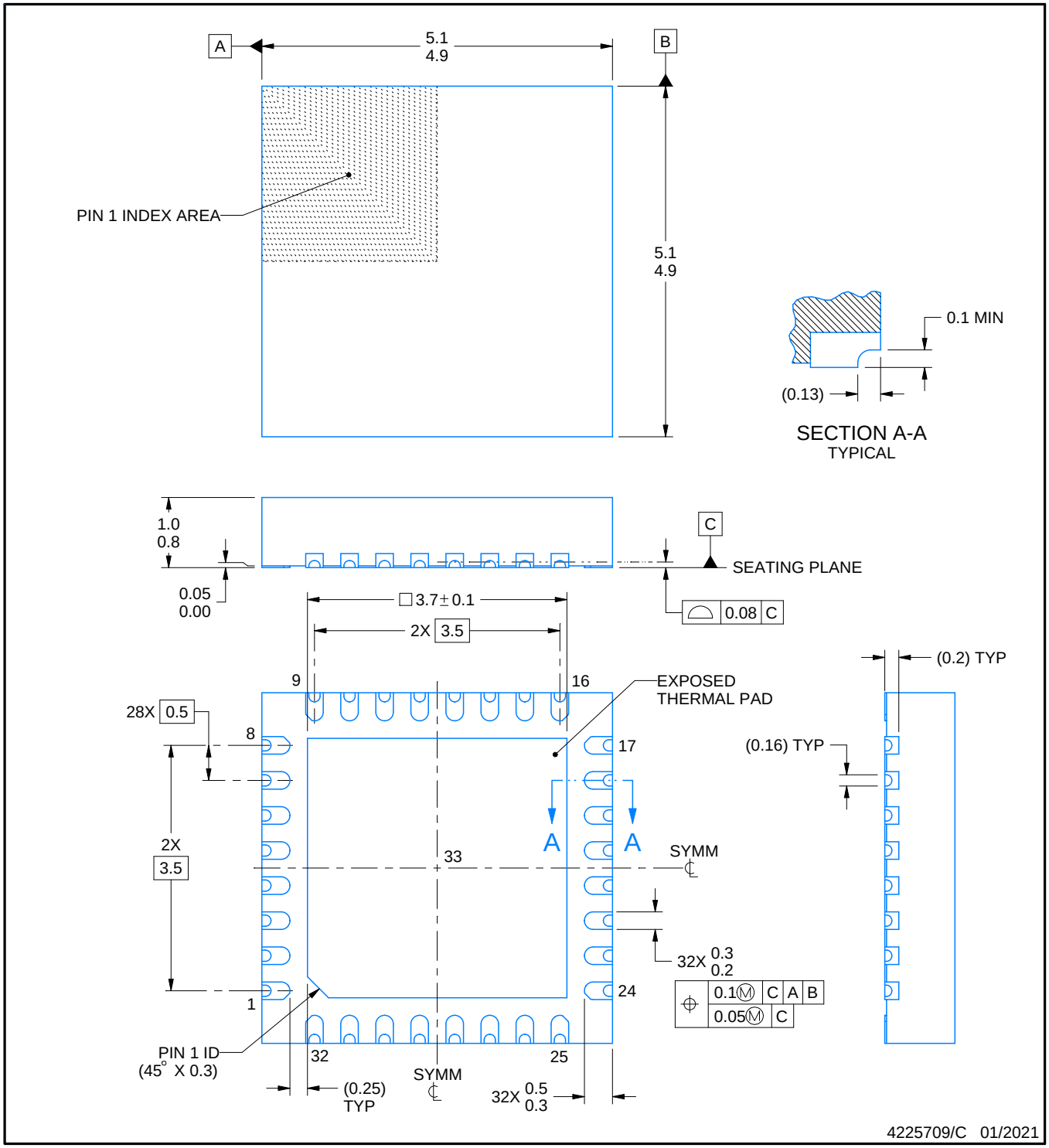
4224745/A

RHB0032U

PACKAGE OUTLINE

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



NOTES:

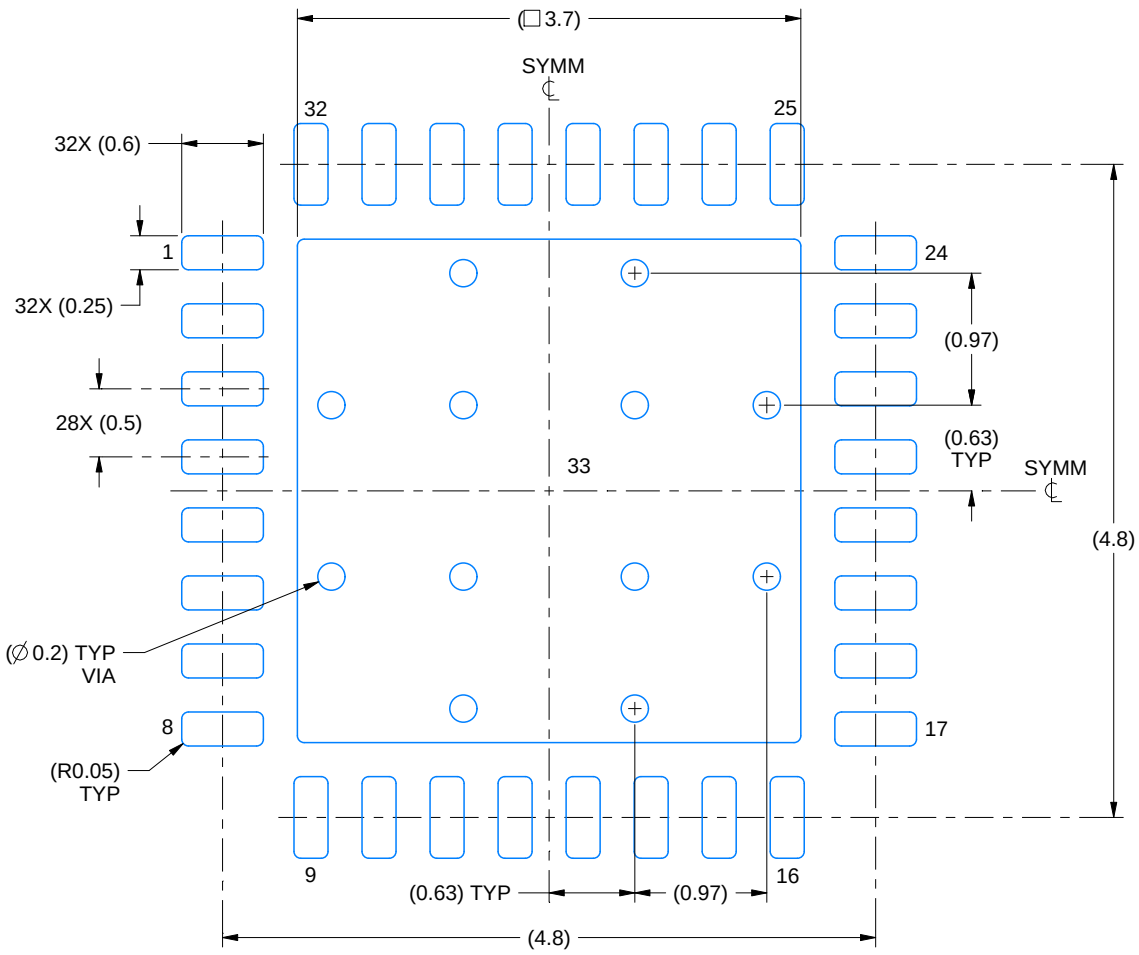
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

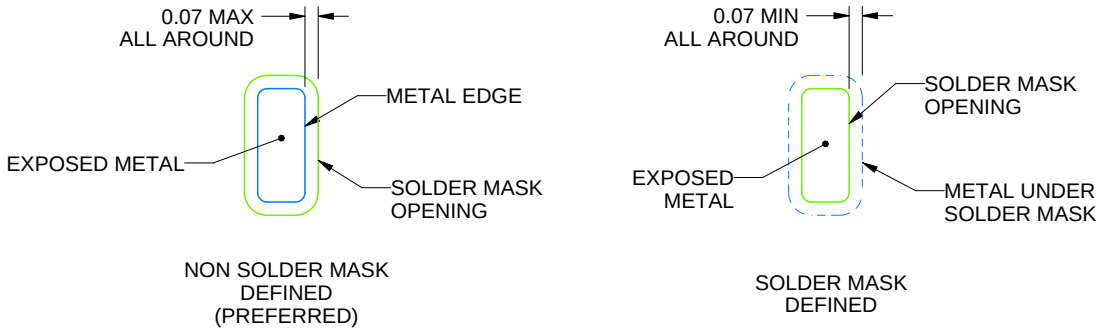
RHB0032U

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:18X

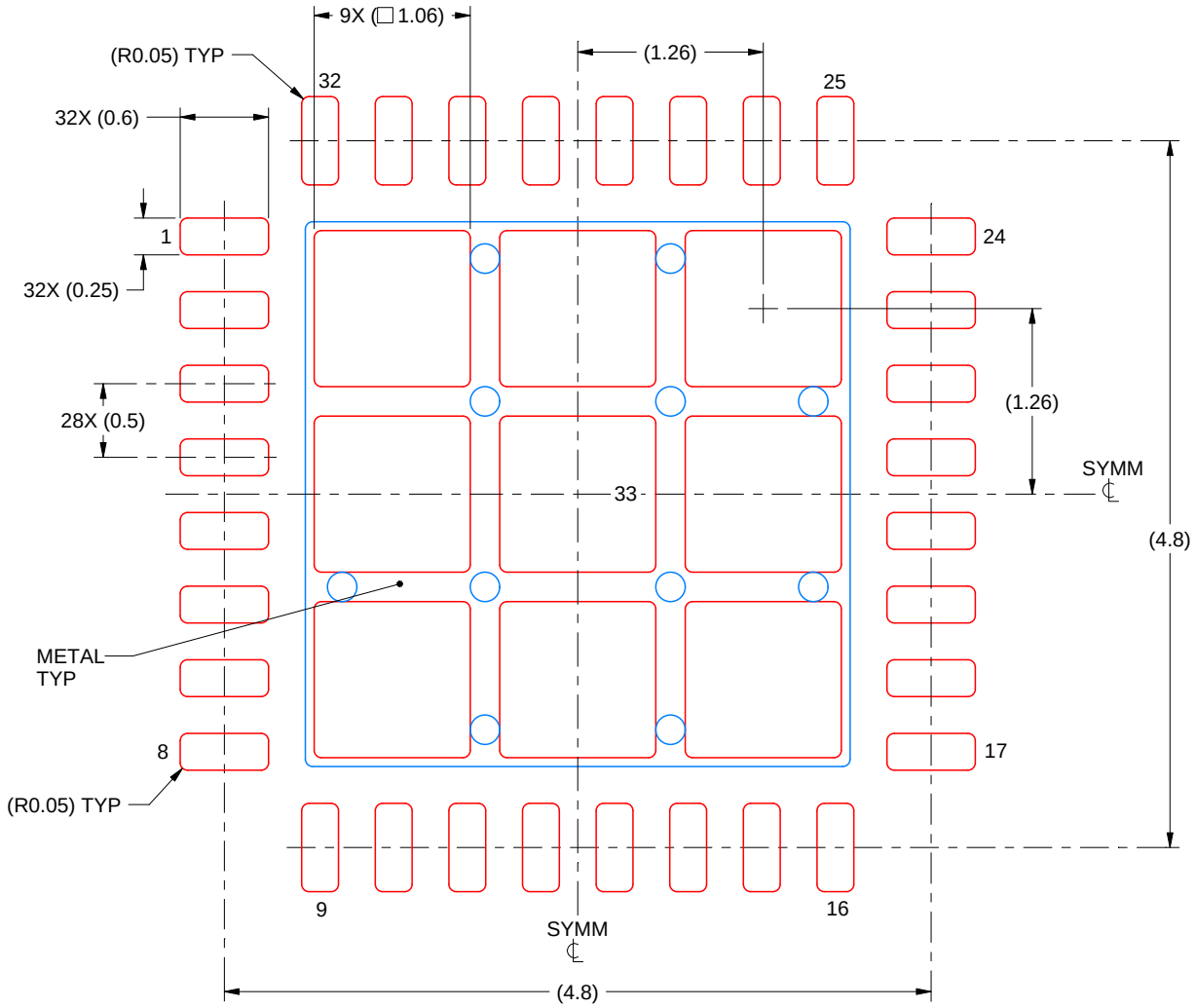


SOLDER MASK DETAILS

4225709/C 01/2021

NOTES: (continued)

4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD 33:
74% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
SCALE:20X

4225709/C 01/2021

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 销售条款)、TI 通用质量指南 或 ti.com 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。 除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月